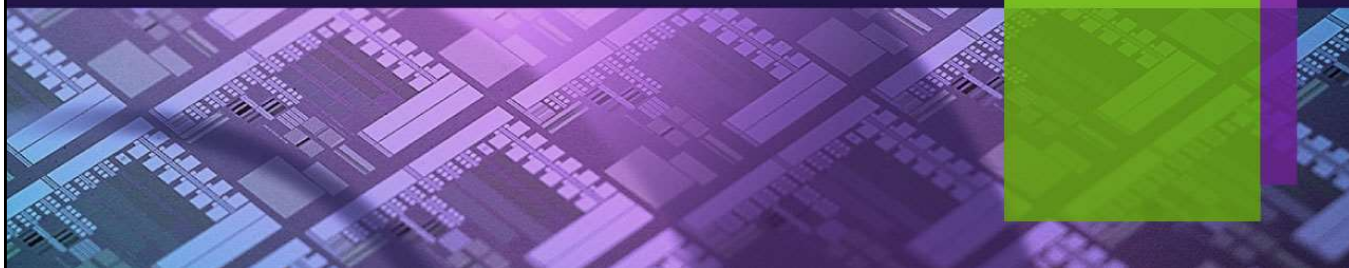


2025年3月期 第3四半期（2024年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年2月6日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

第3四半期 連結決算の概要

2025年2月6日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



改めまして、川本でございます。私から、2025年3月期、第3四半期 連結決算の概要をご説明いたします。

損益状況（四半期）

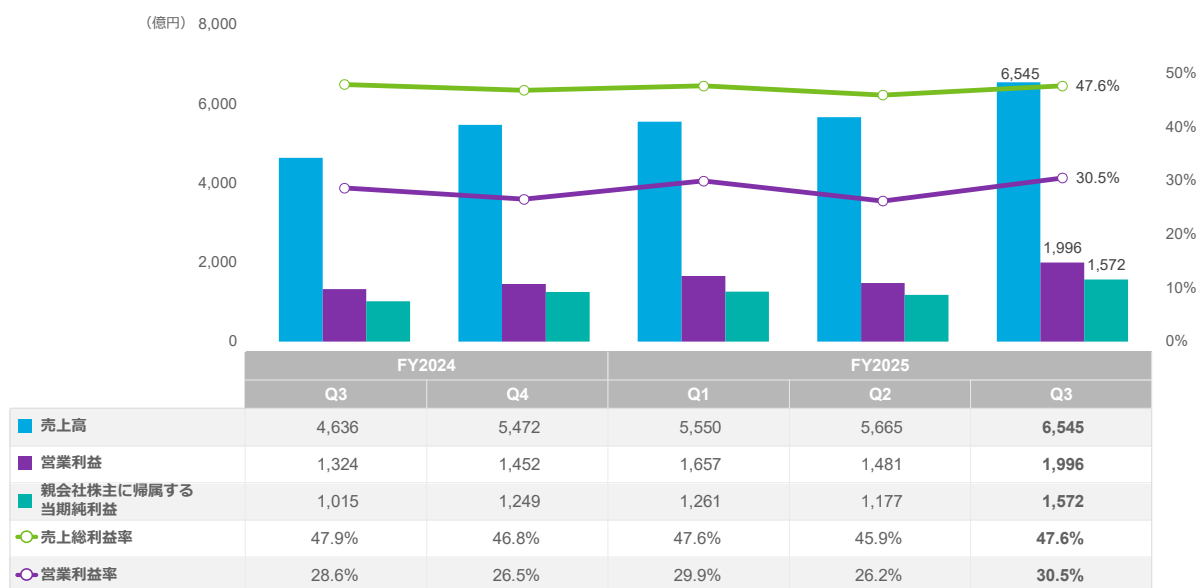
(億円)

	FY2024		FY2025			vs. Q2 FY2025	vs. Q3 FY2024
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
売上高	4,636	5,472	5,550	5,665	6,545	+15.5%	+41.2%
売上総利益	2,221	2,561	2,640	2,599	3,117	+19.9%	+40.4%
売上総利益率	47.9%	46.8%	47.6%	45.9%	47.6%	+1.7pts	-0.3pts
販管費	896	1,108	982	1,117	1,121	+0.3%	+25.1%
営業利益	1,324	1,452	1,657	1,481	1,996	+34.7%	+50.7%
営業利益率	28.6%	26.5%	29.9%	26.2%	30.5%	+4.3pts	+1.9pts
税金等調整前当期純利益	1,344	1,578	1,672	1,536	2,001	+30.3%	+48.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,015	1,249	1,261	1,177	1,572	+33.6%	+54.9%
研究開発費	497	584	534	620	618	-0.4%	+24.1%
設備投資額	318	329	239	533	502	-5.7%	+57.8%
減価償却費	138	153	132	145	160	+10.8%	+16.4%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

こちらは、四半期ごとの「損益状況」です。青枠の部分を中心にご覧ください。
第3四半期の売上高は、前四半期比 15.5%増加の 6,545億円となりました。四半期の売上高としましては、過去2番目に高い水準でした。売上総利益は、19.9%増加の3,117億円。売上総利益率は、売上高の増加に伴い、前四半期比1.7ポイント増加の47.6%となりました。
営業利益は、前四半期比34.7%増加の、1,996億円。営業利益率は、前述した売上総利益率の増加により、前四半期比4.3ポイント増加の30.5%となりました。
税金等調整前当期純利益は、前四半期比30.3%増加の2,001億円。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比 33.6%増加の 1,572億円となりました。
第3四半期の設備投資額は502億円でした。開発用の評価装置を中心に、将来の成長を見据えた投資を継続しております。

損益状況（四半期）



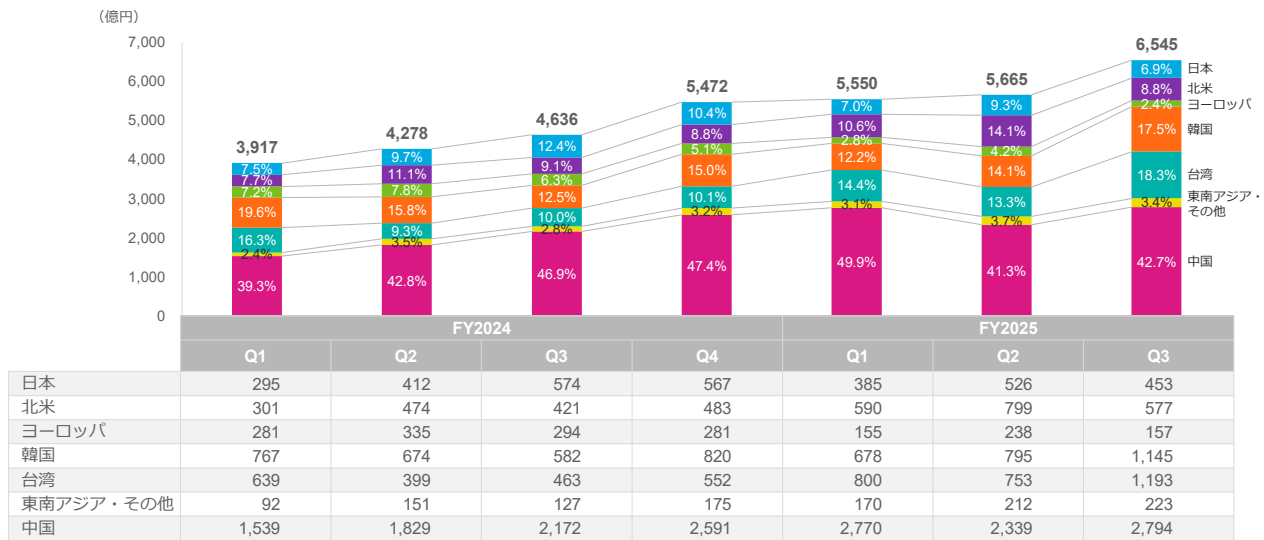
Investor Relations / February 6, 2025

TEL

5

こちらのグラフは、先ほどご説明させていただいた業績を四半期別に時系列で示しております。ご確認ください。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1～FY2025 Q3）



Investor Relations / February 6, 2025

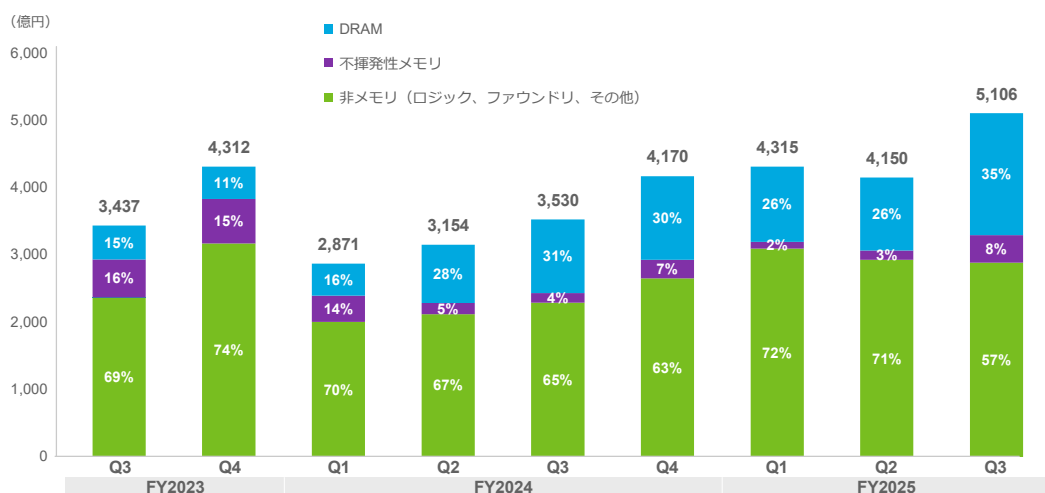
TEL

6

こちらは、「地域別売上高」です。

第3四半期の構成比におきましては、台湾で前四半期比5.0ポイント、韓国で前四半期比3.4ポイントの増加がみられました。中国につきましては、第2四半期と同様に、40%台前半で推移いたしました。

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）

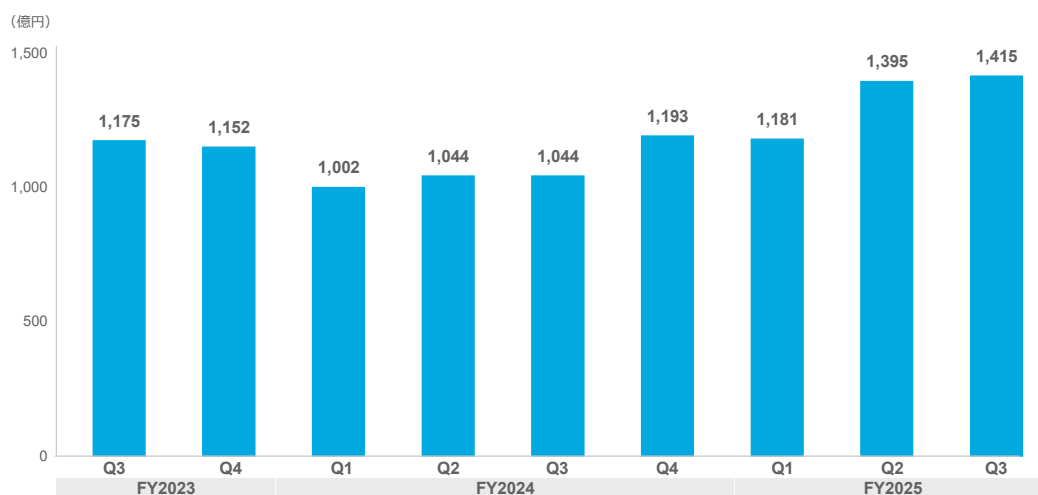


*1 SPE：半導体製造装置

*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

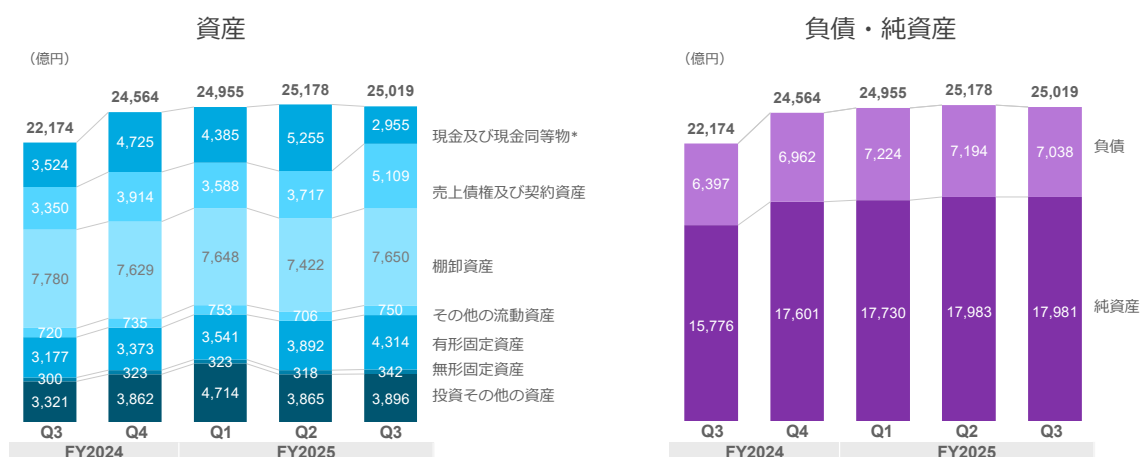
こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」です。
 第3四半期の構成比は、下から非メモリ 57%、不揮発性メモリ 8%、DRAM 35%となりました。DRAM向けの売上が伸び、構成比は前四半期比9ポイント増となりました。

フィールドソリューション売上高（四半期）



こちらは、「フィールドソリューション売上高」です。
第3四半期は19億円増加の、1,415億円となりました。パーツ・サービスの売上高については、顧客稼働率の上昇に伴い、増加いたしました。また、改造案件についても、堅調に推移いたしました。

貸借対照表（四半期）



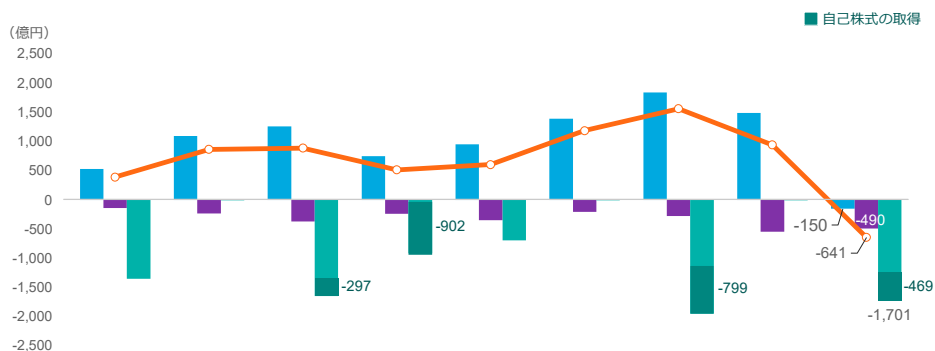
*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。

資産合計は、2兆5,019億円となりました。現金同等物は、2,955億円。株主様への配当金の支払や自己株式の取得、納税等により、前四半期から2,300億円減少いたしました。売上債権及び契約資産は、主要なお客様の投資回復もあり、11月・12月に売上が集中しております。この結果、前四半期比1,392億円増加の5,109億円となりました。棚卸資産は、前四半期比227億円増加の7,650億円。投資その他の資産は前四半期から31億円増加し、3,896億円となりました。

続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、前四半期から156億円減少の7,038億円となりました。純資産は、前四半期比2億円減少の1兆7,981億円となりました。なお、自己資本比率は71.2%となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2023		FY2024				FY2025		
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
■ 営業キャッシュ・フロー	532	1,096	1,257	748	950	1,390	1,837	1,486	-150
■ 投資キャッシュ・フロー ^{*1}	-138	-231	-368	-234	-344	-203	-273	-544	-490
■ 財務キャッシュ・フロー	-1,346	-5	-1,641	-908	-693	-6	-1,944	-6	-1,701
○ フリーキャッシュ・フロー ^{*2}	393	865	888	514	606	1,187	1,564	941	-641
手元資金残高 ^{*3}	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385	5,255	2,955

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

Investor Relations / February 6, 2025

続きまして、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。

この四半期における営業キャッシュフローは、さきほど触れました一過性の売上債権の増加および中間納付、税金の支出により、150億円の支出となりました。投資キャッシュフローの支出は、開発用評価装置を主とした固定資産の取得により、490億円。財務キャッシュフローの支出は、1,701億円。こちらは、先ほどご説明したとおり、株主様への配当金の支払・自己株式の取得によるものです。この結果フリーキャッシュフローは、641億円の支出となりました。なおフリーキャッシュフローは第4四半期に改善し大幅なプラスを見込んでおります。

自己株式の取得状況

■ 2024年12月31日現在

- 取得した株式の総数 2,024,200 株
- 株式の取得価額の総額 46,951,329,991 円

ご参考

■ 2025年1月31日現在（取得終了）

- 取得した株式の総数 2,901,300 株
- 株式の取得価額の総額 69,999,869,491 円

（2024年11月12日開催の取締役会における決議の内容）

- 取得対象株式の種類 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 350 万株（上限） ※自己株式を除く発行済み株式総数に対する割合 0.8%
- 株式の取得価額の総額 700 億円（上限）
- 取得する期間 2024年11月13日～2025年1月31日

最後に、「自己株式の取得状況」をお伝えいたします。
2024年12月31日現在、取得した株式の総数は、202万4,200株、株式の取得価額の総額は、469億円となりました。なお、直近、2月3日に適時開示いたしましたとおり、こちらの自己株式の取得につきましては、1月にすべて終了いたしましたのでお知らせいたします。以上、2025年3月期 第3四半期「連結決算の概要」をご報告いたしました。

事業環境および業績予想

2025年2月6日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



河合でございます。「事業環境 および 業績予想」について、ご説明致します。

事業環境（2025年2月時点でのWFE市場の見方）

- **CY2024：\$110B程度で着地。期初想定を\$10B上回る**
 - 中国顧客における納期の前倒しに加え、AIサーバー向け投資が活況
- **CY2025：前年同等の\$110B程度と予想**
 - 車載やパワー半導体投資、中国新興メーカーの投資は一服
 - AIサーバー向け需要に伴う最先端ロジックとHBM*1が投資を牽引
- **CY2026: 二桁成長を期待**

大容量・超高速・高信頼性・低消費電力の実現に向け、
スケーリングとヘテロジニアスインテグレーションの2軸で技術革新が進展。
GAA*2・Backside PDN*3・HBMやテスト工程など、TELの事業機会は拡大

まず、「事業環境」について、ご説明します。

昨年 CY2024のWFE市場は、期初の想定を10Bドルほど上回り、110Bドルで着地したと見ています。AIサーバー向けの先端投資が活況だったことや、中国のお客様の納期前倒しもあり、想定を上回りました。

本年CY2025のWFE市場は、それらの前倒しと、車載やパワー半導体、中国新興メーカーなどの成熟投資に一服感があることから、前年同等の110Bドル程度と予想します。3か月前の想定からは若干下回るものの、非常に強いAI向け半導体の需要は引き続き拡大しており、技術進化に伴い、最先端ロジックやHBMが投資を牽引し、WFEとしては過去最高レベルが継続します。

そして、CY2026も、AI関連の投資拡大がWFEを牽引します。AIサーバー向けGPU/ASICは、現行の4nm世代から、3nm世代が主力になり、搭載されるHBMも、現在の8層から12層、16層へ微細化を伴いながら増加します。加えて、スマホやPCなど、エッジ側へのAIの本格導入も開始され、2nmのロジックやDDR5の需要が見込まれます。これらにより、WFE市場は二桁成長を期待しております。

AI用途には、最先端の半導体技術が求められます。大容量、超高速、高信頼性、低消費電力の半導体デバイスの実現に向け、半導体の代名詞であるスケーリングと、新たな牽引役であるヘテロジニアスインテグレーションの2軸で技術革新が進展します。GAA、Backside PDN、高積層メモリや、テスト工程などの技術進化に伴い、当社のビジネス機会はますます拡大していきます。

FY2025 Q3 事業進捗

- 売上・利益等、すべての指標において計画を達成
 - Q3：売上高 6,545億円、営業利益 1,996億円、営業利益率 30.5%
 - CYベースでの成長率は+26%となり、市場成長を大きくアウトパフォーム
- 戦略製品によるPOR^{*1}獲得・開発評価も順調に進捗
 - 極低温エッチング装置：NAND チャンネルホール向け量産採用決定
 - 枚葉成膜装置 Episode™ 1：ロジック Backside PDN向け量産採用決定
- 新製品を2機種リリース。SAM^{*2}の拡大を目指す
 - PVD装置 LEXIA™ -EX
スループット20%向上、フットプリント40%削減、CO₂排出量14%削減
 - レーザー剥離装置 Ulucus™ LX
純水使用量 90%以上削減、ウェーハ当たりの有効チップ数増加、
剥離後のシリコンウェーハを再利用する技術も開発中

*1 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定
*2 SAM (Served Available Market) : 参入市場の規模
Investor Relations / February 6, 2025

次に、「FY2025 第3四半期の 事業進捗」についてご説明します。
業績については、先ほど川本から説明しました通り、売上・利益、すべての指標において計画を達成しました。CYベースでの売上成長率は26%となり、市場成長を大きくアウトパフォームしました。中国市場の拡大に加え、AI関連を中心とした投資が、市場成長を牽引していますが、当社においても、最先端向けの量産投資の本格化に向け、先端口ジック、HBM用途のDRAM、アドバンスドパッケージへの引き合いが増加し、新製品比率を押し上げており、それが、今期通期での過去最高の売上・利益につながる見込みです。今期も、付加価値の高い戦略製品で、PORを順調に獲得しております。皆さまにご期待いただいております、極低温エッチング装置は、NAND向け1社で、量産採用が決定し、複数社での評価も着実に進捗しております。また、2024年7月発表の枚葉成膜装置 Episode™ 1において、ロジック Backside PDNの量産PORを、すべての主要顧客より獲得しました。界面制御性の高さから、コンタクト抵抗を下げられる点と、高い生産性が評価されました。また新たに、昨年12月、ご覧の2機種をリリースしました。生産性や環境性能向上も備えており、SAMの拡大に繋げていきます。

拡大する事業機会：豊富な製品ラインアップ

Front-end

3D Integration

Deposition

Lithography

Etch

Cleaning

Testing

Bonding /
Debonding



Batch Deposition Semi-batch Deposition Single Deposition



Coater/
Developer



Plasma Etch Gas Chemical Etch



Cleaning



Prober



Wafer Bonder/
Debonder Wafer Edge Trimming

2025年2月26日のIR Dayにて、それぞれの成長戦略をご説明

Investor Relations / February 6, 2025

TEL 15

中期経営計画の達成に向け、PORの獲得や新製品の展開など、順調に進捗しております。当社は、こちらに示すように、半導体の代名詞であるスケールングに強みのある、幅広い製品ラインアップをそろえておりますが、前工程向けの製品だけでなく、今後重要な Advanced packagingへのソリューションも積極的に提供していきます。2月26日に実施するIR Dayで、それぞれの事業責任者から、今後の成長戦略について説明いたします。皆さま是非、ご参加ください。拡大するWFE市場において、それぞれの装置群でシェア No.1を目指し、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

東京エレクトロン宮城 生産新棟計画

- 延床面積：約88,600m²（予定）
* 付帯設備エリア除く
- 構造：鉄骨造/全免震構造
地上5階建て
- 建設費用：約1,040億円
- 用途：エッチング装置の生産

生産新棟（2027年夏 竣工予定）



物流の自動化や製造工程の機械化を取り入れ、高い生産能力と高品質で
高効率な製造ラインを構築し、次世代生産（Smart-Production）を実現

また、拡大するWFE市場のなかでも、ドライエッチング装置事業は、技術革新に伴う工程増加とシェア拡大により、特に大きな成長が期待されています。そのポテンシャルを最大限に取り込むべく、このたび、東京エレクトロン宮城に生産新棟を建設することを決定しました。生産新棟は、次世代生産のあり方を実現するスマートプロダクション構想にもとづき、物流機能の自動化や製造工程の機械化を取り入れます。これにより、現行比で労働生産性4倍、スペース効率2倍、生産リードタイム1/3を目指します。

FY2025 業績予想

次に、「FY2025の 業績予想」について説明致します。

FY2025 業績予想

(億円)

	FY2024 (実績)	FY2025			
		H1 (実績)	H2 (予想)	通期 (予想)	通期 YoY
売上高	18,305	11,216	12,783	24,000	+31.1%
売上総利益	8,302	5,239	6,050	11,290	+36.0%
売上総利益率	45.4%	46.7%	47.3%	47.0%	+1.6pts
販管費	3,740	2,100	2,389	4,490	+20.1%
研究開発費	2,028	1,154	1,386	2,540	+25.2%
研究開発費以外の販管費	1,711	945	1,003	1,950	+14.0%
営業利益	4,562	3,139	3,660	6,800	+49.0%
営業利益率	24.9%	28.0%	28.6%	28.3%	+3.4pts
税金等調整前当期純利益	4,734	3,208	3,701	6,910	+46.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	2,439	2,820	5,260	+44.5%
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	528.67	-	1,142.47	+358.72

FY2025通期の売上成長率は30%超。市場成長を大きくアウトパフォーム

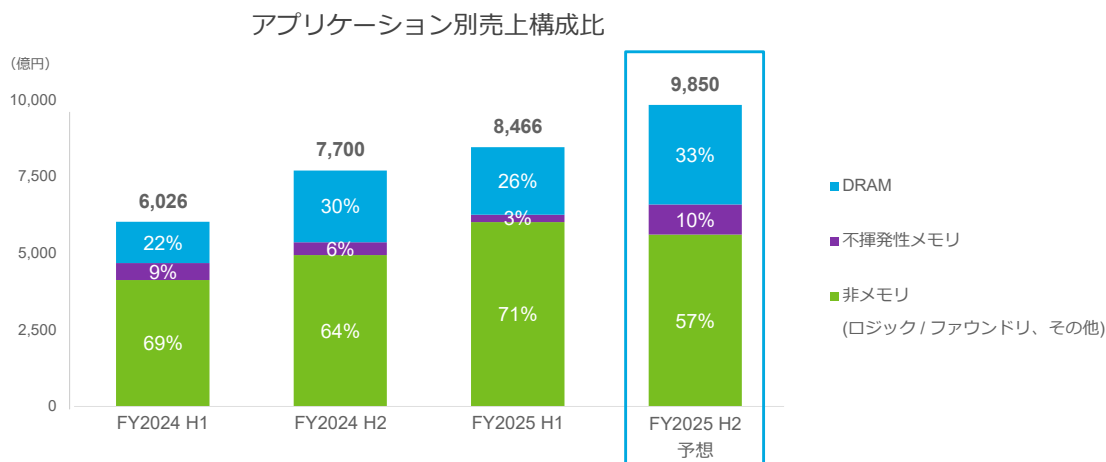
Investor Relations / February 6, 2025

TEL

18

業績予想は、3か月前に1,000億円上方修正しております。今回はそこから変更はなく、FY2025の、通期売上高は2兆4,000億円、前期から、プラス31%の成長となり、市場成長を大きくアウトパフォームする見込みです。詳細は御覧の表のとおりですが、売上高、売上総利益、売上総利益率、営業利益、当期純利益、及び、EPSは、過去最高となる計画です。

FY2025 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

FY2025H2は過去最高の半期売上を予想

次に、SPE 新規装置の売上予想です。第3四半期の進捗により、今下期は、過去最高となる売上 9,850億円を着実に達成する見込みです。

FY2025 研究開発費・設備投資計画

新開発棟
成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県韮崎市
2023年7月 竣工

東北生産・物流センター
成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟
コートデベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置

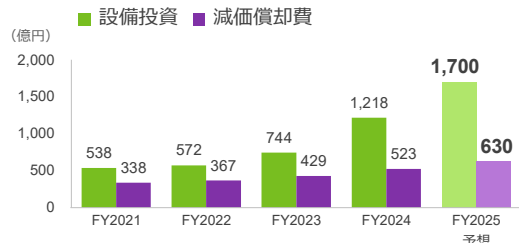
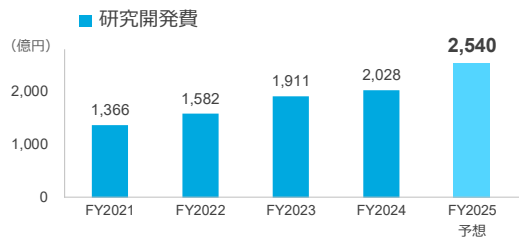


熊本県合志市
2025年夏 竣工予定

新開発棟
エッチング装置



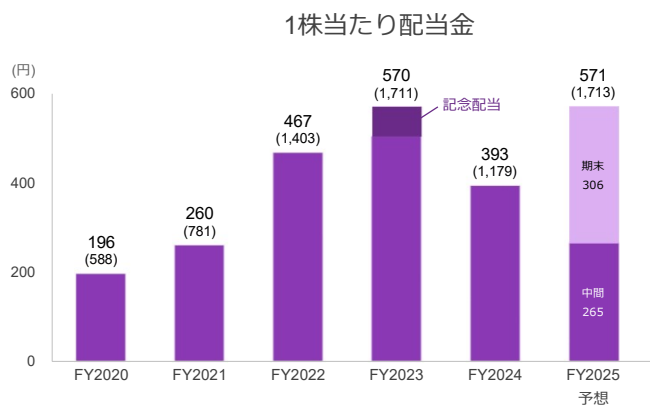
宮城県黒川郡
2025年春 竣工予定



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

次に、「研究開発費と設備投資の計画」です。FY2025の研究開発費は、2,540億円、設備投資、減価償却費はそれぞれ、1,700億円、630億円を見込んでおります。

FY2025 配当予想



- FY2020～2023の1株当たり配当額は、FY2020の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

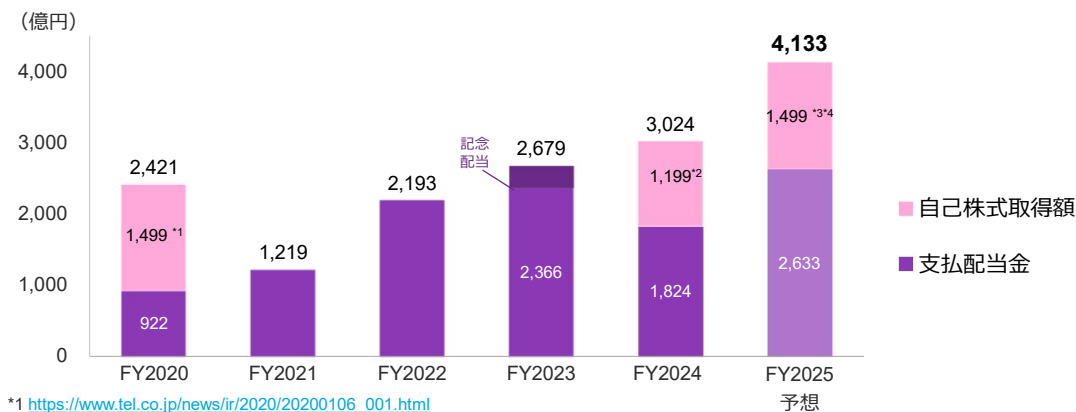
自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は571円を予定

次に、「配当予想」についてです。今期の1株当たりの配当は、過去最高だった2023年3月期を上回り、通期で571円を予定しております。

総還元額



*1 https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106_001.html

*2 https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002_001.pdf

*3 https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/tin2lg00000000c0-att/20240701_001.pdf

*4 https://www.tel.co.jp/news/ir/2025/kb8thq00000000ot-att/20250203_001.pdf

自己株式取得と合わせ、過去最高の総還元額を見込む

こちらは最後のスライド、「総還元額の推移」になります。今期の総還元額は、先程ご説明した1株あたり配当額と、今期追加で取得した自己株式を合わせ、前期2024年3月期を1,000億円以上上回り、4,133億円と、過去最高の総還元額になる見込みです。私からのご報告は以上となります。ご清聴ありがとうございました。

